

(19)



JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: **2001102629 A**

(43) Date of publication of application: **13.04.01**

(51) Int. Cl.

H01L 33/00
H01S 5/343

(21) Application number: **11273948**

(22) Date of filing: **28.09.99**

(71) Applicant: **NICHIA CHEM IND LTD**

(72) Inventor: **MARUI HIROMITSU**
TANIZAWA KOJI

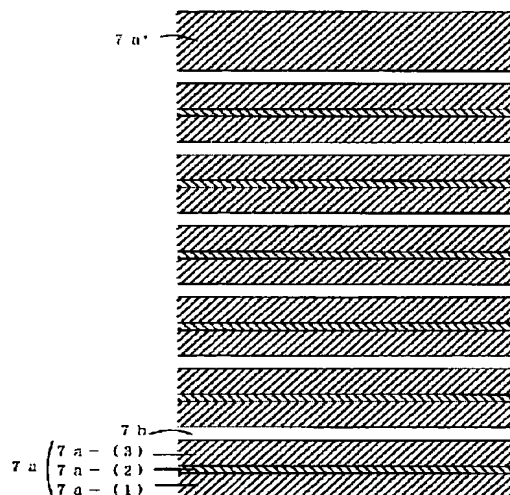
(54) NITRIDE SEMICONDUCTOR ELEMENT

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a nitride semiconductor element in which the forward voltage is lowered through use of an active layer of multiple quantum well structure in order to widen application range to various products.

SOLUTION: Forward voltage of a nitride semiconductor element can be lowered without sacrifice of the element characteristics by subjecting the well layer of an active layer having multiple quantum well structure or the single layer of a barrier wall layer to modulation doping with n-type impurities.

COPYRIGHT: (C)2001,JPO



(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2001-102629

(P2001-102629A)

(43) 公開日 平成13年4月13日 (2001.4.13)

(51) Int.Cl.⁷

識別記号

F I

テ-マ-ト* (参考)

H 0 1 L 33/00

H 0 1 L 33/00

C 5 F 0 4 1

H 0 1 S 5/343

H 0 1 S 5/343

5 F 0 7 3

審査請求 有 請求項の数 3 O L (全 6 頁)

(21) 出願番号 特願平11-273948

(22) 出願日 平成11年9月28日 (1999.9.28)

(71) 出願人 000226057

日亜化学工業株式会社

徳島県阿南市上中町岡491番地100

(72) 発明者 丸居 宏充

徳島県阿南市上中町岡491番地100 日 亜

化学工業株式会社内

(72) 発明者 谷沢 公二

徳島県阿南市上中町岡491番地100 日 亜

化学工業株式会社内

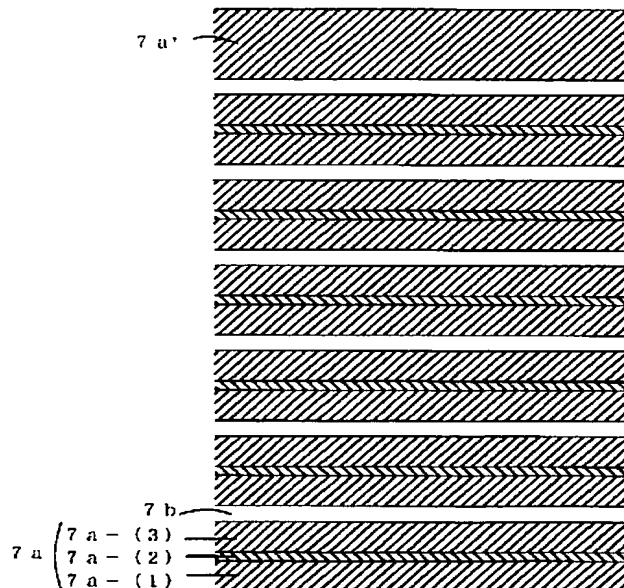
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 窒化物半導体素子

(57) 【要約】

【課題】 多重量子井戸構造の活性層を用い、種々の応用製品への適用範囲の拡大を可能とするため、順方向電圧の低い窒化物半導体を提供する。

【解決手段】 多重量子井戸構造からなる活性層の井戸層又は障壁層の単一層中に n 型不純物を変調ドーピングすることで素子特性を悪化させることなく順方向電圧を低減することが可能な窒化物半導体素子が得られる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上に、少なくともn型窒化物半導体層、活性層及びp型窒化物半導体層を順に有する窒化物半導体素子において、前記活性層が井戸層にInを有する窒化物半導体を含んでなる多重量子井戸構造からなり、前記井戸層もしくは障壁層の単一層中にn型不純物が変調ドーピングされていることを特徴とする窒化物半導体素子。

【請求項2】 前記障壁層は、アンドープの窒化物半導体からなる下層、n型不純物がドーピングされている窒化物半導体からなる中間層、及びアンドープの窒化物半導体からなる上層の少なくとも3層が順に積層されていることを特徴とする請求項1に記載の窒化物半導体素子。

【請求項3】 前記n型不純物はSi、Ge、Snの少なくとも1種であることを特徴とする請求項1に記載の窒化物半導体素子。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、発光ダイオード(LED)、レーザーダイオード(LD)、太陽電池、光センサー等の発光素子、受光素子、あるいはトランジスタ、パワーデバイス等の電子デバイスに使用される窒化物半導体(例えば、 $\text{In}_x\text{Al}_y\text{Ga}_{1-x-y}\text{N}$ 、 $0 \leq x$ 、 $0 \leq y$ 、 $x+y \leq 1$)素子に関する。

【0002】

【従来技術】窒化物半導体は高輝度青色LED、純緑色LEDの材料として、フルカラーLEDディスプレイ、交通信号灯、イメージスキャナー光源等の各種光源で実用化されている。これらのLED素子は基本的に、サファイヤ基板状にGaNよりなるバッファ層、SiドーピングのGaNよりなるn型コンタクト層と、InGaN系単一量子井戸構造(SQW: Single-Quantum-Well)あるいはInGaN系多重量子井戸構造(MQW: Multi-Quantum-Well)の活性層と、MgドーピングAlGaNよりなるp型クラッド層と、MgドーピングGaNよりなるp型コンタクト層とが順に積層された構造を有している。

【0003】20mAにおいて、波長450nmの青色LEDは、単一量子井戸構造では発光出力2.5mW、外部量子効率5%、多重量子井戸構造では発光出力5mW、外部量子効率9.1%であり、また、波長520nmの緑色LEDは、単一量子井戸構造構造では発光出力2.2mW、外部量子効率4.3%、多重量子井戸構造では発光出力3mW、外部量子効率6.3%と非常に優れた特性を示す。

【0004】このように、上記出願人が開示したLED素子は、高出力であり実用に十分適用でき信号などの種々の製品に適用されている。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、近年の

省エネなどに応じて、発光出力の低下を伴わずに消費電力を低減させることが可能なLED素子が望まれている現在において、上記のLED素子は十分ではない。上記LED素子は20mAにおいて順方向電圧(V_f)は3.6V近くあり、さらなる低下が望まれている。

【0006】そこで本発明は、上記問題点を解決し、素子特性に優れた窒化物半導体素子を提供することを目的とする。

【0007】

10 【課題を解決するための手段】すなわち、本発明は、基板上に少なくともn型窒化物半導体層、活性層及びp型窒化物半導体層を順に有する窒化物半導体素子において、前記活性層が井戸層にInを有する窒化物半導体を含んでなる多重量子井戸構造からなり、前記井戸層もしくは障壁層の単一層中にn型不純物が変調ドーピングされていることを特徴とする。これにより、素子特性が悪化することなく順方向電圧を低減することが可能な窒化物半導体素子を提供することができる。

20 【0008】本発明の請求項2に記載の窒化物半導体素子は、アンドープの窒化物半導体からなる下層、n型不純物がドーピングされている窒化物半導体からなる中間層、及びアンドープの窒化物半導体からなる上層の少なくとも3層が順に積層されている障壁層を有している。これにより障壁層に接している井戸層への不純物の拡散を最小限に防ぎ、井戸層の結晶性が悪化することを抑制できる。

【0009】本発明の請求項3に記載の窒化物半導体素子は、Si、Ge、Snから選択される少なくとも1種のn型不純物を井戸層又は障壁層に有する。

30 【0010】本発明において、アンドープの窒化物半導体層とは意図的に不純物をドーピングしない窒化物半導体層を示し、例えば原料に含まれる不純物、反応装置内のコンタミネーション、意図的に不純物をドーピングした他の層からの意図しない拡張により不純物が混入した層及び微量なドーピングにより実質的にアンドープと見なせる層(例えば抵抗率 $3 \times 10^{-1} \Omega \cdot \text{cm}$ 以上)も本発明ではアンドープと定義する。

40 【0011】本発明において、n型不純物が窒化物半導体層に含有されていることを、添加、又はドーピングなどと示す場合がある。

【0012】

【発明の実施の形態】本願発明者は種々の実験の結果、発光出力低下を最小限に抑さえつつ順方向電圧を低減できる窒化物半導体を見出し本発明を成すに至った。

【0013】多重量子井戸構造は膜厚が大きくなるため、不純物を有していないアンドープの活性層では抵抗が高くなってしまふ。活性層にn型もしくはp型の不純物を加えれば抵抗を低下することができる。

50 【0014】しかし、不純物の濃度が高すぎるとその層もしくはその層に接している層の結晶性が悪くなり、発

光出力が低下する傾向がある。

【0015】そこで今回、活性層中の井戸層もしくは障壁層の単一層中にn型不純物をドーピングする際、変調にドーピングすることで、活性層を悪化させることなく順方向電圧の低減を可能とする、素子特性に優れた窒化物半導体素子を形成する。

【0016】図1に本発明の形態である、窒化物半導体素子の素子構造の模式的断面図を示す。以下、本実施の形態の窒化物半導体素子について詳述する。

【0017】図1は、基板1上、バッファ層2、アンドープGaN層3、n型不純物を含むn型コンタクト層4、アンドープの下層、n型不純物ドーピングの中間層及びアンドープの上層の3層からなるn型第1多層膜層5、第3及び第4の窒化物半導体層よりなるn型第2多層膜層6、多重量子井戸構造の活性層7、p型不純物を含むp型多層膜層8、p型不純物ドーピングGaNよりなるp型コンタクト層が順に積層された構造を有する。更にn型コンタクト層4上にn電極11、p型コンタクト層9上にp電極10がそれぞれ形成される。

【0018】(活性層7) 本発明において、活性層7は、井戸層7bにInを有する窒化物半導体を含んでなる量子井戸構造であり、井戸層7bと障壁層7aとを順次積層した多層膜構造の多重量子井戸構造である。井戸層7bと障壁層7aとの積層順は、特に問わず、井戸層7bから積層して井戸層7bで終わる、井戸層7bから積層して障壁層7aで終わる、障壁層7aから積層して障壁層7aで終わる、また障壁層7aから積層して井戸層7bで終わっても良い。活性層7の膜厚は特に限定されず、LED素子などの希望の波長等を考慮して、井戸層7b及び障壁層7aの各積層数や積層順を調整し活性層の総膜厚を調整する。具体的には200~8000オングストロームであり、好ましくは500~6000オングストロームである。活性層7の総膜厚が上記範囲であると発光出力及び活性層7の結晶成長に要する時間の点で好ましい。

【0019】(井戸層) 井戸層はInを有する窒化物半導体を含有している。井戸層の単一膜厚としては100オングストローム以下、好ましくは70オングストローム以下、さらに好ましくは50オングストローム以下に調整する。井戸層の膜厚の下限は特に限定されていないが、1原子層以上、好ましくは10オングストローム以上である。井戸層の単一膜厚が上記範囲であると、発光出力の向上及び発光スペクトル半値幅の減少の点で好ましい。

【0020】(障壁層7a) 一方、障壁層7aの単一膜厚は30~500オングストロームであり、好ましくは50~300オングストロームに調整する。障壁層7aが上記範囲であると光電変換効率が向上し、低V_f及び低リーク電流となり好ましい。また、障壁層7aは井戸層7bよりもバンドギャップエネルギーが大きい窒化物

半導体を選択し、好ましくはIn_yGa_{1-y}N (0 ≤ y < 1, X > Y) 又はAl_zGa_{1-z}N (0 < z < 0.5) とする。ただし、井戸層7b及び障壁層7aをInAlNとすることも可能である。

【0021】(n型不純物) 本発明で活性層7にドーピングするn型不純物にはSi、Ge、Sn、S、O、Ti、Zr等のIV族、若しくはVI族元素を用いることができる。好ましくはSi、Ge、Snを、さらに好ましくはSiを用いる。

【0022】(変調ドーピング) 活性層7にn型不純物をドーピングする際、井戸層7bもしくは障壁層7aの単一層中において変調ドーピングする。変調ドーピングとは、一方の層の不純物濃度を小さく、好ましくは不純物をドーピングしない状態のアンドープとし、その隣り合うもう一方を高濃度にドーピングする方法で、閾値電圧、順方向電圧等を低減させることができる。これは不純物濃度の低い層を多層膜層中に存在させることにより、その層の移動度が大きくなり、また不純物濃度が高濃度の層も同時に存在することにより、キャリア濃度が高いままで多層膜層が形成できることによる。つまり、不純物濃度が低い移動度の高い層と、不純物濃度が高いキャリア濃度が大きい層とが同時に存在することにより、キャリア濃度が大きく、移動度も大きい層がクラッド層となるために、閾値電圧、順方向電圧が低下すると推察される。なお、変調ドーピングする場合には、不純物濃度差は1桁以上とすることが好ましい。

【0023】本発明で、井戸層7bにn型不純物をドーピングする場合、単一層中にn型不純物ドーピング層とアンドープ層の2層構造にすることが好ましい。n型不純物のドーピング量(濃度)は、 $1 \times 10^{17} / \text{cm}^3 \sim 1 \times 10^{19} / \text{cm}^3$ 、好ましくは $6 \times 10^{17} / \text{cm}^3 \sim 7 \times 10^{18} / \text{cm}^3$ 、より好ましくは $9 \times 10^{17} / \text{cm}^3 \sim 5 \times 10^{18} / \text{cm}^3$ である。またドーピング層の膜厚は、10オングストローム~50オングストローム、好ましくは10オングストローム~30オングストローム、より好ましくは10オングストローム~20オングストロームである。

【0024】一方、本発明で障壁層7aにn型不純物をドーピングする場合、単一層中にアンドープの窒化物半導体からなる下層7a-(1)、n型不純物がドーピングされている窒化物半導体からなる中間層7a-(2)、及びアンドープの窒化物半導体からなる上層7a-(3)の少なくとも3層が順に積層された3層構造にすることが好ましい。n型不純物のドーピング量(濃度)は、 $1 \times 10^{17} / \text{cm}^3 \sim 1 \times 10^{19} / \text{cm}^3$ 、好ましくは $6 \times 10^{17} / \text{cm}^3 \sim 7 \times 10^{18} / \text{cm}^3$ 、より好ましくは $9 \times 10^{17} / \text{cm}^3 \sim 5 \times 10^{18} / \text{cm}^3$ である。またドーピング層の膜厚は、10オングストローム~100オングストローム、好ましくは10オングストローム~60オングストローム、より好ましくは10オングストローム~30オングストロームである。この範囲であると良好な結晶性

と低い抵抗率を得る点で好ましい。

【0025】

【実施例】以下、本発明の実施例について説明する。なお、本発明は以下に示す実施例のみに限定されるものではない。

【0026】【実施例1】図1を元に、本発明の素子の実施例1の製造方法について述べる。

【0027】(基板1) サファイア(C面)よりなる基板1をMOVPEの反応容器内にセットし、容器内を水素で十分に置換した後、水素を流しながら基板の温度を1050℃まで上昇させ、基板のクリーニングを行う。基板1はサファイアC面の他、R面、A面を主面とするサファイア基板、スピネル(MgAl₂O₄)のような絶縁性の基板、SiC(6H、4H、3Cを含む)、Si、ZnO、GaAs、GaN等の半導体基板を用いることができる。

【0028】(バッファ層2) 続いて温度を510℃まで下げ、キャリアガスに水素、原料ガスにアンモニアとTMG(トリメチルガリウム)とを用い、基板上にGaNよりなるバッファ層2を約200オングストロームの膜厚で成長させる。なお、このバッファ層2は基板の種類、成長方法によっては省略できる。また、このバッファ層2はAlの割合の小さいAlGaNを用いることもできる。

【0029】(アンドープGaN層3) バッファ層2成長後、TMGのみを止めて、温度を1050℃まで上昇させる。1050℃になったら、同じく原料ガスにTMG、アンモニアガスを用い、アンドープGaN層3を1.5μmの膜厚で成長させる。

【0030】(n型コンタクト層4) 続いて1050℃で、同じく原料ガスにTMG、アンモニアガス、不純物ガスにシランガスを用い、Siを $5 \times 10^{18} / \text{cm}^3$ ドープしたGaNよりなるn型コンタクト層4を2.165μmの膜厚で成長させる。

【0031】(n型第1多層膜層5) 次に、シランガスのみを止め、1050℃でTMG、アンモニアガスを用い、アンドープGaNよりなる下層を3000オングストロームの膜厚で成長させ、続いて同温度にてシランガスを追加しSiを $4 \times 10^{18} / \text{cm}^3$ ドープしたGaNよりなる中間層を300オングストロームの膜厚で成長させ、更に続いてシランガスのみを止め、同温度にてアンドープGaNからなる上層を50オングストロームの膜厚で成長させ、3層からなる層膜厚3350オングストロームのn型第1多層膜層5を成長させる。

【0032】(n型第2多層膜層6) 次に、同様の温度で、アンドープGaNよりなる窒化物半導体層を40オングストローム成長させ、次に温度を800℃にしてTMG、TMI、アンモニアを用い、アンドープIn_{0.3}Ga_{0.7}Nよりなる窒化物半導体層を20オングストローム成長させる。これらの操作を繰り返し、交互に10

層ずつ積層した超格子構造の多層膜よりなるn型第2多層膜層6を600オングストロームの膜厚で成長させる。

【0033】(活性層7) 次にTMG、アンモニアを用いアンドープのGaNよりなる下層7a-(1)を120オングストロームの膜厚で成長させる。続いて同温度にてシランガスを追加しSiを $1 \times 10^{18} / \text{cm}^3$ ドープしたGaNよりなる中間層7a-(2)を10オングストロームの膜厚で成長させ、更に続いてシランガスのみを止め、同温度にてアンドープGaNからなる上層7a-(3)を120オングストロームの膜厚で成長させ、このような3層からなる総膜厚250オングストロームの障壁層7aを成長させる。

【0034】次に、同様の温度で、TMG、TMI、アンモニアを用い、アンドープIn_{0.3}Ga_{0.7}Nよりなる井戸層7bを30オングストロームの膜厚で成長させる。これらの操作を繰り返し、Siをドープした3層構造の障壁層7aとアンドープの井戸層7bを交互に6層ずつ積層させる。最後にアンドープの障壁層7a'を膜厚250オングストロームで積層させ、総数13層、総膜厚1930オングストロームの多重量子井戸構造よりなる活性層を成長させる。これにより、障壁層は7層中下方から6層目までがSiドープの3層構造となる。

【0035】(p型多層膜層8) 次に、温度1050℃でTMG、TMA、アンモニア、Cp₂Mg(シクロペンタジエニルマグネシウム)を用い、Mgを $5 \times 10^{19} / \text{cm}^3$ ドープしたp型Al_{0.2}Ga_{0.8}Nよりなる窒化物半導体層を40オングストロームの膜厚で成長させ、続いて温度を800℃にして、TMG、TMI、アンモニア、Cp₂Mgを用いMgを $5 \times 10^{19} / \text{cm}^3$ ドープしたIn_{0.02}Ga_{0.98}Nよりなる窒化物半導体層を25オングストロームの膜厚で成長させる。これらの操作を繰り返し、p型AlGaN層とp型InGaN層を交互に5層ずつ積層して、総数10層、総膜厚325オングストロームの超格子構造の多層膜よりなるp型多層膜層8を成長させる。

【0036】(p型コンタクト層9) 続いて1050℃で、TMG、アンモニア、Cp₂Mgを用い、Mgを $1 \times 10^{20} / \text{cm}^3$ ドープしたp型GaNからなるp型コンタクト層9を1200オングストロームの膜厚で成長させる。

【0037】反応終了後、温度を室温まで下げ、さらに窒素雰囲気中、ウェーハを反応容器内において700℃でアニーリングを行い、p型層を更に低抵抗化する。

【0038】アニーリング後、ウェーハを反応容器から取り出し、最上層のp型コンタクト層の表面に所定の形状のマスクを形成し、RIE(反応性イオンエッチング)装置でp型コンタクト層9側からエッチングを行い、図1に示すようにn型コンタクト層4の表面を露出させる。

【0039】エッチングによりp n各半導体表面を露出させた後、スパッタリング法により各電極をそれぞれ形成させる。

【0040】こうして得られたLED素子は、20mAにおいて463nmの青色発光を示し、 V_f は3.36V、発光出力は6.5mWであった。

【0041】【実施例2】活性層7を形成する際、Siをドーブした3層構造の障壁層7aを、7層のうち全て7層をSiドーブの3層構造とする他は実施例1と同様にしてLED素子を形成した。

【0042】こうして得られたLED素子は、20mAにおいて468nmの青色発光を示し、 V_f は3.4V、発光出力は6.5mWであった。

【0043】【実施例3】活性層7を形成する際、Siをドーブした3層構造の障壁層7aを、7層のうち下方から3層目までがSiドーブの3層構造とし、上部4層をアンドープの障壁層7a'とする他は実施例1と同様にしてLED素子を形成した。

【0044】こうして得られたLED素子は、20mAにおいて471nmの青色発光を示し、 V_f は3.45V、発光出力は6.69mWであった。

【0045】【実施例4】活性層7の障壁層7aを形成する際、TMG、アンモニアを用いアンドープのGaNよりなる下層7a-(1)を116.6オングストロームの膜厚で成長させ、続いて同温度にてシランガスを追加しSiを $1 \times 10^{18} / \text{cm}^3$ ドーブしたGaNよりなる中間層7a-(2)を16.8オングストロームの膜厚で、更に続いてシランガスのみを止め、同温度にてアンドープGaNからなる上層7a-(3)を116.6オングストロームの膜厚で成長させ、このような3層からなる総膜厚250オングストロームの障壁層7aを成長させる他は実施例1と同様にしてLED素子を形成した。

【0046】こうして得られたLED素子は、20mAにおいて459nmの青色発光を示し、 V_f は3.27V、発光出力は6.03mWであった。

【0047】【実施例5】活性層7の障壁層7aを形成する際、TMG、アンモニアを用いアンドープのGaNよりなる下層7a-(1)を141.6オングストロームの膜厚で成長させ、続いて同温度にてシランガスを追加しSiを $1 \times 10^{18} / \text{cm}^3$ ドーブしたGaNよりなる中間層7a-(2)を16.8オングストロームの膜厚で成長させ、更に続いてシランガスのみを止め、同温度にてアンドープGaNからなる上層7a-(3)を141.6オングストロームの膜厚で成長させ、このような3層からなる総膜厚300オングストロームの障壁層7aを成長させる他は実施例1と同様にしてLED素子を形成した。

【0048】こうして得られたLED素子は、20mAにおいて459nmの青色発光を示し、 V_f は3.40

V、発光出力は5.93mWであった。

【0049】【実施例6】活性層7の障壁層7aを形成する際、TMG、アンモニアを用いアンドープのGaNよりなる下層7a-(1)を166.6オングストロームの膜厚で成長させ、続いて同温度にてシランガスを追加しSiを $1 \times 10^{18} / \text{cm}^3$ ドーブしたGaNよりなる中間層7a-(2)を16.8オングストロームの膜厚で成長させ、更に続いてシランガスのみを止め、同温度にてアンドープGaNからなる上層7a-(3)を166.6オングストロームの膜厚で成長させ、このような3層からなる総膜厚350オングストロームの障壁層7aを成長させる他は実施例1と同様にしてLED素子を形成した。

【0050】こうして得られたLED素子は、20mAにおいて457nmの青色発光を示し、 V_f は3.45V、発光出力は6.41mWであった。

【0051】【実施例7】活性層7の障壁層7aを形成する際、TMG、アンモニアを用いアンドープのGaNよりなる下層7a-(1)を191.6オングストロームの膜厚で成長させ、続いて同温度にてシランガスを追加しSiを $1 \times 10^{18} / \text{cm}^3$ ドーブしたGaNよりなる中間層7a-(2)を16.8オングストロームの膜厚で成長させ、更に続いてシランガスのみを止め、同温度にてアンドープGaNからなる上層7a-(3)を191.6オングストロームの膜厚で成長させ、このような3層からなる総膜厚400オングストロームの障壁層7aを成長させる他は実施例1と同様にしてLED素子を形成した。

【0052】こうして得られたLED素子は、20mAにおいて459nmの青色発光を示し、 V_f は3.50V、発光出力は6.21mWであった。

【0053】【実施例8】活性層7の障壁層7aを形成する際、TMG、アンモニアを用いアンドープのGaNよりなる下層7a-(1)を241.6オングストロームの膜厚で成長させ、続いて同温度にてシランガスを追加しSiを $1 \times 10^{18} / \text{cm}^3$ ドーブしたGaNよりなる中間層7a-(2)を16.8オングストロームの膜厚で成長させ、更に続いてシランガスのみを止め、同温度にてアンドープGaNからなる上層7a-(3)を241.6オングストロームの膜厚で成長させ、このような3層からなる総膜厚500オングストロームの障壁層7aを成長させる他は実施例1と同様にしてLED素子を形成した。

【0054】こうして得られたLED素子は、20mAにおいて462nmの青色発光を示し、 V_f は3.55V、発光出力は6.31mWであった。

【0055】

【発明の効果】以上説明したように、基板上に少なくともn型窒化物半導体層、活性層及びp型窒化物半導体層を順に有する窒化物半導体素子において、前記活性層が

井戸層にInを有する窒化物半導体を含んでなる多重量子井戸構造からなり、前記井戸層もしくは障壁層の単一層中にn型不純物を変調ドーピングすることで、素子特性の悪化を引き起こすことなく順方向電圧を低減することができる。バリア層のうち、最終に積層されるラストバリア層へのドーピングの有無による違いは特に見られなかったが、ラストバリア層がp型多層膜層、p型コンタクト層の下地となることを考慮すると、ラストバリア層はアンドープが望ましいと考えられる。

【図面の簡単な説明】

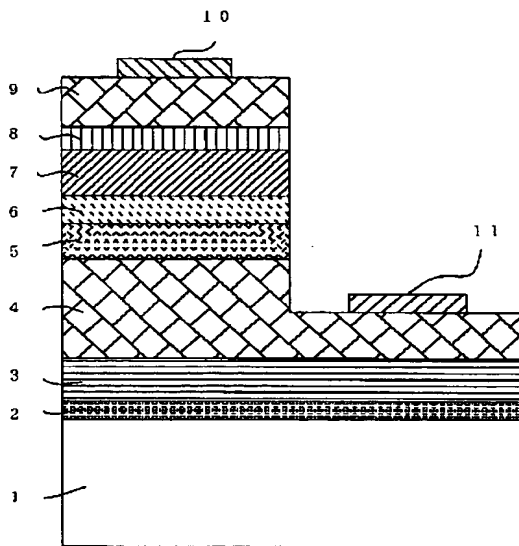
【図1】本発明の一実施の形態であるLED素子の構造を示す模式的断面図である。

【図2】本発明の一実施の形態であるLED素子の活性層の構造を示す模式的断面図である。

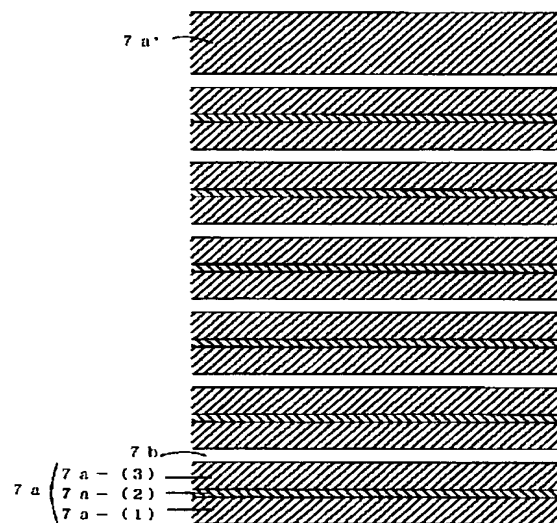
1・・・サファイア基板

2・・・パッファ層

【図1】



【図2】



フロントページの続き

Fターム(参考) 5F041 AA24 CA05 CA33 CA34 CA35
CA40 CA46 CA54 CA56 CA57
CA65 CA73 CA74 FF01 FF13
5F073 AA74 BA09 CA07 CB02 CB05
CB17 CB22 DA05 DA16 DA21
EA29

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.